

苏州天脉导热科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	上海证券、西部证券、上海信托、汇添富基金、中欧基金、平安养老保险、中邮电子、华安基金、华夏基金、中金证券
时间	2025年7月14日至2025年7月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书：龚才林 证券事务专员：尹静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>龚才林先生简要介绍了公司的业务发展情况。公司成立于2007年，成立之初，公司主要产品为导热界面材料，由于其核心技术的掌握依赖于长期的研发投入和技术沉淀，在中高端产品领域技术壁垒较高，市场长期由欧美及日本厂商所垄断。公司自成立以来，在该领域不断投入技术力量进行配方研发和工艺改进，经过十余年的持续发展，导热界面材料已发展成为公司的优势产品。公司成功开发的高导热、低挥发、低出油导热硅胶片等系列产品大量应用于消费电子、安防监控、汽车电子、通信设备等中高端产品市场。</p> <p>2010年起，以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品迅猛发展，伴随产品轻薄化、小型化发展所带来的散热需求的增加，消费电子领域在传统导热界面基础上大量应用石墨散热材料，公司于2012年自主开发人工合成石墨材料并顺利推出市场。</p> <p>公司分别自2014年、2017年着手对热管、均温板技术进行研发储备，该阶段由于市场需求尚不明朗，产品量产难度较高，行业内鲜有涉</p>

足者，但公司基于对电子散热行业趋势的前瞻性预判，坚持在相关领域进行创新投入与技术积累，储备了大量工艺技术、人才与市场资源。

公司与投资者主要交流情况：

1、问：请简要介绍下，在智能手机领域散热产品的应用情况？

答：在智能手机领域，根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组合使用，传统4G手机通常采用“导热界面材料+石墨膜”组合作为散热方案，在5G手机、中高性能4G手机等领域，工作功耗及散热要求相对更高，通常采用“导热界面材料+石墨膜+热管/均温板”组合或“导热界面材料+热管/均温板”组合作为散热方案。

2、问：公司目前生产基地是如何分布的，未来生产基地将如何规划？

答：公司当前生产基地位于苏州、浙江嵊州（租赁厂房）及越南北宁（租赁厂房）。嵊州天脉于2024年购置54亩土地建设自有厂房，目前上述厂房尚处于建设过程中。在现有的生产基地基础上，公司拟购置100亩土地用于投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地建设项目。上述项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

随着公司生产基地规模的不断扩大，公司将持续强化热管理材料及器件的生产制造能力以满足日益增长的市场需求。

3、问：请问公司目前有没有实施股权激励的计划或安排？

答：公司在上市前已向公司高级管理人员及核心员工实施了股权激励，并且公司高级管理人员及核心员工也参与了公司首次公开发行股票的战略配售。公司将综合考虑经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，在未来适宜时机实施股权激励计划，完善公司的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性。

	<p>4、问：请问公司是否已进入北美客户的供应链，能否介绍一下具体进展情况？</p> <p>答：公司目前处于向该客户送样测试阶段，未来能否进入其供应链尚存在不确定性，敬请投资者理性判断，注意投资风险。若有新的应披露的进展，公司将根据上市公司相关规则，合规披露相关信息。</p> <p>5、问：公司对 2025 年的业绩有何展望？</p> <p>答：2025 年度公司营业收入预计较 2024 年度增长 10%左右。该目标的实现受行业竞争格局、市场供需变化及公司经营管理等多重因素影响，存在不确定性，具体收入实现情况以公司最终结果为准。敬请投资者理性判断，注意投资风险。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 7 月 21 日</p>